

11月1日(水)10:00-12:25
KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:25 (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)
◆来賓挨拶 京都府副知事 山下 晃正 京都市長 門川 大作(予定)
◆基調講演「グローバルトレンドから見る イメージセンサ技術進化の方向性」 ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 代表取締役社長 清水 照士
◆基調講演「データセンサ市場の現状と課題」 特定非営利活動法人日本データセンター協会 理事長 兵庫県立大学 特任教授 白川 功
◆基調講演「企業理念と新中期経営計画 VG (Value Generation) 2.0」 オムロン(株) 取締役 執行役員 専務 CFO兼グローバル戦略本部長 日戸 興史
◆基調講演「半導体100兆円の時代がやってきた!! ~フラッシュメモリ、各種センサ-製造装置で示す 日本企業の存在感」 (株)産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉
11月2日(木)9:30-11:55
KM-2 マーケティングセッション 9:30-11:55 (受付 9:00 開始)
司会:松下晋司(株)産業タイムズ社)
◆特別講演「EV、IoTが半導体産業を牽引する時代」 IHS グローバル(株) 調査ディレクター 南川 明
◆特別講演「スーパーサイクルを迎えたハイテク業界と さらなる発展の可能性」 野村證券(株) エクイティ・リサーチ部 エレクトロニクス・グループ マネージング・ディレクター 和田木 哲哉
◆特別講演「更に揺れるFPD業界、 LCD/OLED/新技術?、業界再編の鍵を握るのは?」 みずほ証券(株)エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・ テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト 中根 康夫

コース
【A】 次世代 自動車
【B】 次世代 IoTデバイス
【C】 メモリー 新時代到来

11月1日(水)14:00-16:40
A-1 自動運転 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープ)
◆ADAS/自動運転の最新動向と2030年の市場展望 ~大変革期を迎える自動車産業~ 株式会社野村総合研究所自動車産業グループ プロジェクトマネージャー 池山 智也 ◆人と車の融和を推進するドライバー理解技術 オムロン(株)技術・知財本部センシング研究開発センター 画像センシング研究室 主査 相澤 知禎 ◆NVIDIAが実現するLevel5 へのカウントダウン エヌビディア合同会社 オートモーティブビジネス事業部長 浜田 勝
B-1 応用 岡田吉生(GF)/小田川明弘(パナソニック)
◆水中ロボットによるダムインフラ維持管理 パナソニック(株)コネクティッドソリューションズ社イノベーションセンター メカトロソリューション開発部 部長 九郎丸 俊一 ◆IoTとセンサが活躍する次世代農業 ベンジタ(株) 代表取締役社長 小池 聡 ◆VR HMD VIVEの特徴と製造業を中心とした国内外での活用事例 HTC NIPPON(株) Director of Sales Operation, VIVE JAPAN 西川 美優
C-1 材料・装置 藤原健典(東レ)/酒井滋樹(日新イオン機器)/不破保博(ローム)
◆3次元構造メモリの製造プロセスを支えるドライエッチング技術 東京エレクトロン(株) エッチングシステムマーケティング部 Market Analyst 道順 麻貴子 ◆次世代IoTクラウド社会を実現する高密度実装線順: TSVプロセス・装置の新提案 (株)アルバック 半導体電子技術研究所 第3研究部 第1研究室 室長 森川 泰宏 ◆低線膨張銅めっき液の特性と事業化 大阪府立大学 微小めっき研究所 所長 教授 近藤 和夫

11月2日(木)12:50-15:05
A-2 電動車 山崎治(シャープ)/松浦正純(ルネサス)
◆次世代自動車の市場展望 ~パワートレインの長期見通しと自動運転による市場創造~ カノラモーター(株)代表取締役 宮尾 健 ◆日産ノボ-POWERの開発 日産自動車(株)パワートレイン開発本部 パワートレイン主管 仲田 直樹 ◆ホンダの電動化技術とエネルギーマネジメント (株)本田技術研究所 R&DセンターX 執行役員 岩田 和之
B-2 デバイス 宮崎信(村田製作所)/酒井滋樹(日新イオン機器)
◆IoT市場向け センサ無線 ソリューション開発動向 ローム(株)産業戦略部 IoTソリューション課 課長 小宮 邦裕 ◆クラスターイオン注入によるCMOSセンサ向け シリコンウェーハの近接ゲッタリング技術 (株)SUMCO 技術本部 評価・基盤技術部 担当部長 栗田 一成 ◆新方式LPWA無線システムおよびデバイスの開発 ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) IoTソリューション事業部 Principal Engineer 北園 真一
C-2 デバイス・応用① 廣田良浩(東京エレクトロン)/山本浩之(マイクロメモリジャパン)
◆超大容量ストレージを実現する3次元フラッシュメモリ (BiCS FLASH™)技術 東芝メモリ(株)先端メモリ開発センター 技監 青地 英明 ◆Micron 3D NAND Breakthroughs Help Next Generation Storage マイクロメモリジャパン(株)ストレージ・ビジネス・ユニット シニア・マーケティング・マネージャー 服部 昇 ◆データセンサの最新動向とデータセンサ内のICT装置・半導体に 求められる要件 富士通(株)サービスプラットフォーム戦略企画室エスケイティブ・アーキテクト 大阪大学 次世代クラウド協働研究所 副所長 藤巻 秀明

11月2日(木)15:35-17:50
A-3 車載キーデバイス 中村孝(ローム)/佐藤高史(京都大学)
◆ルネサスが描く次世代自動車の最先端半導体技術と未来への取り組み ルネサス エレクトロニクス(株)オートモーティブソリューション事業本部 技師長 板垣 克彦 ◆車載ネットワークの動向とLSIに要求される対応 (株)メガチップス ASP事業本部高速有線通信事業部 事業部長 金銅 恒 ◆車載キーデバイス SiCパワーデバイスの現状 ローム(株)パワーデバイス生産本部ハイパワーデバイス製造部商品企画G グループリーダー 三浦 峰生
B-3 次世代技術 重松智志(NTT)/佐々木元(メガチップス)
◆極低電力LSIデバイス(SOTB)の最新動向 ルネサス エレクトロニクス(株) 生産本部 デバイス開発統括部 先端デバイス開発部 部長 山口 泰男 ◆半導体材料を用いた人工光合成技術の最新動向と展望 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 首席研究員 佐山 和弘 ◆IoTラストワンマイルを担うLoRaWANの 最新技術動向とその活用事例 (株)ソラコム テクノロジー・インフラストラクチャー事業開発マネージャー 松下 亮平
C-3 デバイス・応用② 小田川明弘(パナソニック)/戸所義博(イーセップ)
◆メモリ新時代到来! ~いつまでも"新世代"ではられない~ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹 秋永 広幸 ◆ReRAM基本技術とその研究開発最前線 ~微細化/3次元化/脳型チップ応用など~ パナソニック・センサ/カメラソリューションズ(株) 半導体ビジネスユニット マニファクチャリングセンター ReRAM技術担当主幹 三河 巧 ◆CMOSプロセスと整合性の高い強誘電体ナノ薄膜材料による 不揮発性メモリの新展開 東京大学生産技術研究所 情報・エレクトロニクス系部門 准教授 小林 正治

【D】 特別セッション 産学連携 & パッケージ

D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム 戸所義博(イーセップ)
◆アモルファス酸化物半導体の熱電デバイス応用について 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 助教 上沼 睦典、教授 浦岡 行治 ◆ヘリウムイオン顕微鏡を用いたナノ加工と評価 大阪大学 ナノテクノロジー-設備供用拠点微細加工プラットフォーム 特任助教 法澤 公寛 ◆ナノインプリントによる金属ナノシリンドラー周期アレイの 作製と光学特性 京都大学 工学研究科 助教 村井 俊介

D-2 パッケージング① 藤原健典(東レ)/岡田吉生(GF)
◆進化するFO-WLPテクノロジーと適用アプリケーション (株)SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦 ◆半導体パッケージ基板用絶縁材料技術 味の素(株)バイオ・ファイン研究所 素材・用途開発研究所 素材開発研究室長 中村 茂雄 ◆FO-WLP/PLP向け封止材料の概要と課題、開発状況 パナソニック(株) オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 電子材料事業部技術開発センター先端材料開発部 主任技師 岩谷 絵美

D-3 パッケージング② 山本浩之(マイクロメモリジャパン)/廣田良浩(東京エレクトロン)
◆IoT、トリリオンセンサに向けた小型、低コスト半導体パッケージ ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)アナログLSI事業部 アナログデバイス開発部ニュープロセスマネージャー 尾崎 裕司 ◆大日本印刷(株)のエレクトロニクス関連技術紹介 大日本印刷(株) ファインエレクトロニクス事業部 第2営業本部 営業第2部 新規ビジネス推進グループ シニアエキスパート 吉沼 洋人 ◆無線通信技術を支える LTCC(Low-Temperature-cofired-ceramics)材料、プロセス技術 (株)村田製作所 技術・事業開発本部 マテリアル技術センター 応用材料開発部 プリンシパルリサーチャー 杉本 安隆

【E】 特別セッション 有機EL & アナログパワー

E-1 アナログ(パワー)回路入門 佐藤高史(京都大学)/中村孝(ローム)
◆パワーエレクトロニクスの基礎と先端材料・回路応用技術 大阪大学大学院 工学研究科 電気電子情報工学専攻 システム・制御工学講座 パワースystem領域 教授 舟木 剛 ◆E 級スイッチング回路と高周波数無線電力伝送システム 千葉大学大学院 工学研究科 数学情報科学専攻 教授 関屋 大雄

E-2 有機EL① 重松智志(NTT)/中村孝(ローム)
◆高効率延焼発光材料及びOLEDの最前線 九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター 特任准教授 土屋 陽一 ◆有機ELディスプレイの次世代製造技術とOLEDの挑戦 (株)JOLED CTO室 副室長 厚木技術開発センター センター長 荒井 俊明

E-3 有機EL② 宮崎信(村田製作所)/不破保博(ローム)
◆有機ELディスプレイ市場の最新動向 ディスプレイライフェンション/カンパ/NTT DSCC アジア代表 田村 喜男 ◆有機EL蒸着製造装置の最新技術 キヤノン(株)事業推進部 担当課長 松本 栄一

E-3 有機EL② 宮崎信(村田製作所)/不破保博(ローム)
◆有機ELディスプレイ市場の最新動向 ディスプレイライフェンション/カンパ/NTT DSCC アジア代表 田村 喜男 ◆有機EL蒸着製造装置の最新技術 キヤノン(株)事業推進部 担当課長 松本 栄一